

Publikationen

(2020): Einfluss eines abnormalen $(\text{CuNi})_6\text{Sn}_5/(\text{NiCu})_3\text{Sn}_4$ -Schichtwachstums auf die Robustheit von bleifreien Zinn-Silber-Basis-Lotstellen bei Temperaturen oberhalb von 175 °C. In: Fachtagung/Konferenz EBL 2020 - Elektronische Baugruppen und Leiterplatten, Fellbach.

(2019): Influence of a New Abnormal $(\text{CuNi})_6\text{Sn}_5 / (\text{NiCu})_3\text{Sn}_4$ Layer Growth at Temperatures Above 175°C in Tin Silver Based Lead-Free Solder Joints. In: Proceedings of the SMTA International Conference 2019 (22-26 September 2019; Rosemont, IL, USA).

(2019): Potenziale von hybriden Fertigungsprozessketten. In: 1. TRIOKON 2019 – Die ostbayerische Transferkonferenz für Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft, Regensburg.